



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20091117003A
2011 年 8 月 17 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

ASP u*BGAパッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイヤ変更のご案内
(認定済 33 製品への追加認定 22 製品の連絡)

(初版 PCN20091117003 2010 年 4 月 8 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/> -	
変更内容	下記変更について認定済 33 製品への追加認定 22 製品の連絡になります。 ASP u*BGA パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 ボンディングワイア 変更後 : Cu(銅)線 ボンディングワイア			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	追加認定品は 11 月下旬の出荷より予定しています。 (サンプルは 9 月下旬の出荷より予定しています。) 認定終了品は 2010 年 7 月中旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済33製品への追加認定22製品の連絡になります。弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト) u*BGAパッケージ 一部製品について、ボンディングワイアの機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為、現行 Au(金)線 ボンディングワイアに替わり、Cu(銅)線 ボンディングワイアへの移行を認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイア	Au(金)線	Cu(銅)線

理由：機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為

対象製品リスト

対象製品名				
■:追加認定品 □:認定終了品				
C5509Z00ME1C2103DR	TMS320DA255GHH	TMS320VC5509AZHH	TNETV2505GGW	TNETV2510FNSGGW
D35004AGGW160	TMS320DA255ZHH	TMS320VC5509AZHHR	TNETV2505ZGW	TNETV2510GGW
D35004AGGW200	TMS320DA295CZZG	TMS320VC5510AGGW1	TNETV2510CGGW	TNETV2510IDGGW
D35004AGGWA200	TMS320DM270ZHK	TMS320VC5510AGGW2	TNETV2510ENGGW	TNETV2510VIBGGW
D35004AZGW200	TMS320DM310ZHK22	TMS320VC5510AGGWA1	TNETV2510ENGGWR	TNETV2510VIDGGW
F751517CGHC	TMS320DSP260AGGW2	TMS320VC5510AGGWA2	TNETV2510VIBGGW	TNETV2510VISGGW
F751517CZHC	TMS320SP103AGGW2	TMS320VC5510AZGW2	TNETV2510VIDGGW	TNETV2510VNBGGW
F761572AZZGR	TMS320VC5503ZHH	TMS320VC5510AZGWA1	TNETV2510FISGGW	TNETV2510VNDGGW
OMAP5910JZZG1	TMS320VC5506ZHH	TMS320VC5510AZGWA2	TNETV2510FNBGGW	TNETV2510VNSGGW
OMAP5910JZZG2	TMS320VC5507GHH	TMSDVC5510AGGWA2	TNETV2510FNDGGW	TNETV2510ZGW
OMAP5912ZZG	TMS320VC5509AGHH	TNETV2505CGGW	TNETV2510FNDGGWA2	WDVC5510AZGWA2

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009年11月10日	終了	2010年3月22日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	F761636A	Die Size(mils):	145.630 X 155.157	
Wafer Fab:	DM6	Wafer Technology:	90nm	
Assembly Site:	TIPI	Package Code/Pins:	ZZD/179	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Mold Compound:	KMC	
Moisture Level:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
HTOL	125C, 1000 hrs	50/0	50/0	50/0
**High Temp. Storage Bake	150C, 1008 hrs	96/0	96/0	97/0
Biased HAST	110C/85%RH, 264 hrs	70/0	70/0	70/0
Unbiased HAST	110C/85%RH, 192 hrs	97/0	97/0	96/0
Unbiased HAST	130C/85%RH, 192 hrs	98/0	99/0	99/0
**Temp Cycle	-55/125C, 1000cyc	101/0	103/0	101/0
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3 / 260C				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009年11月10日	終了	2010年3月22日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	TSB43DA42A	Die Size(mils):	158.0 X 137.9	
Wafer Fab:	DM6	Wafer Technology:	120nm	
Assembly Site:	TIPI	Package Code/Pins:	GHC/196	
Bond Wire:	0.8Mil Dia., Cu	Mold Compound:	KMC	
Moisture Level:	JEDEC L-3/220C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**High Temp. Storage Bake	150C, 1008 hrs	90/0	90/0	90/0
Unbiased HAST	130C/85%RH, 192 hrs	90/0	90/0	90/0
**Temp Cycle	-55/125C, 1000cyc	110/0	110/0	110/0
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3 / 220C				